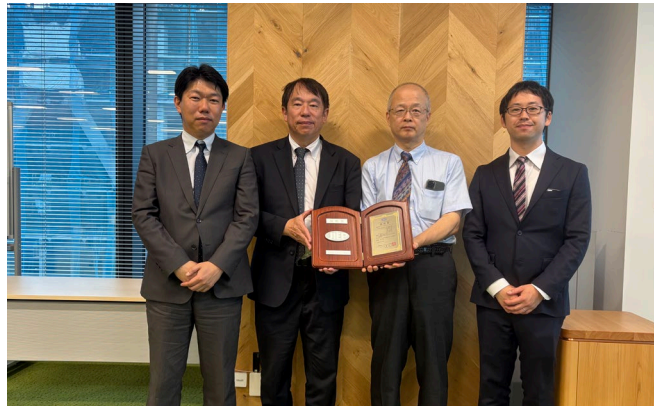


2026年5月25日

各 位

「FaradFlex®」がエレクトロニクス実装学会 技術賞を受賞 ～ 高速・大容量通信社会の課題解決に貢献 ～

当社（社長 池信 省爾）は、このたび薄型基板内蔵キャパシタ材「FaradFlex®」に関する技術が評価され、5月20日に開催された第15回エレクトロニクス実装学会定時総会にて、「エレクトロニクス実装学会 技術賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。同賞はエレクトロニクス実装技術の発展に顕著に寄与した技術に贈られるものです。



FaradFlex®は、IC（半導体チップ）直下にキャパシタ機能を内蔵できる独自の材料構造を有しており、電源供給経路の短縮により電源インピーダンスの低減と高周波領域における信号品質の向上を実現します。電子機器の高速化・大容量化が進む中、通信の安定性向上に寄与する材料として、高性能ルーター、スイッチ、AI サーバー、スーパーコンピュータ向け高多層基板や、スマートフォンに内蔵されるMEMS マイクロフォン用途など、幅広い分野で採用されています。

今回の受賞は、電源品質の改善や信号特性の向上への要求が高まるなか、FaradFlex®の構成材料の改良やキャパシタンス容量向上など継続的な技術開発が、これらの課題に対する有力なソリューションとして高く評価されたものです。

当社は、キャリア付き極薄銅箔 MicroThin™や高周波基板用電解銅箔 VSP™とともに、FaradFlex®を次世代通信・AI 向け材料事業の成長ドライバーと位置付けており、今後もニーズに応じた製品開発とラインアップ拡充により、さらなる収益拡大を見込んでいます。

なお、2026年6月10日～12日に東京ビッグサイトで開催されるJPCA Show 2026にて、本技術に関するパネル展示を行う予定です。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

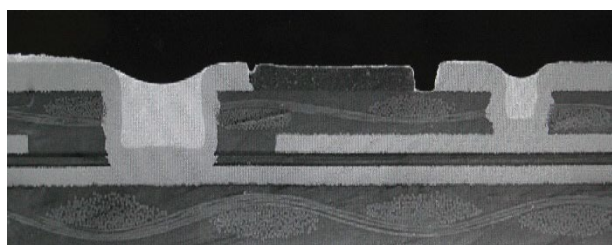
TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com

(ご参考)

1. FaradFlex®の構造

FaradFlex®は、3～25 μm の極薄絶縁層を18～70 μm 厚の銅箔で挟んだサンドイッチ構造を持つ材料です。これを基板に積層して回路を形成することで基板内にキャパシタ層を形成できます。

FaradFlex®を含むプリント配線板断面図



FaradFlex®（銅箔／絶縁層／銅箔の3層構造）

2. 基板内蔵キャパシタの使用イメージ

